

**Dk 3.68 Df 0.0074
@13GHz**

Tg(DSC) 176°C

**T288(銅付)
30分**

用途

ネットワーク/ワイヤレス通信

ICTインフラ機器、スーパーコンピュータ、計測用機器、通信アンテナなど

MEGTRON4 MEGTRON4S MEGTRONM

Laminate

R-5725

Prepreg

R-5620

Laminate

R-5725S

Prepreg

R-5620S

Laminate

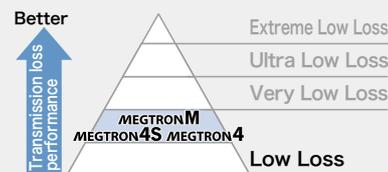
R-5735

Prepreg

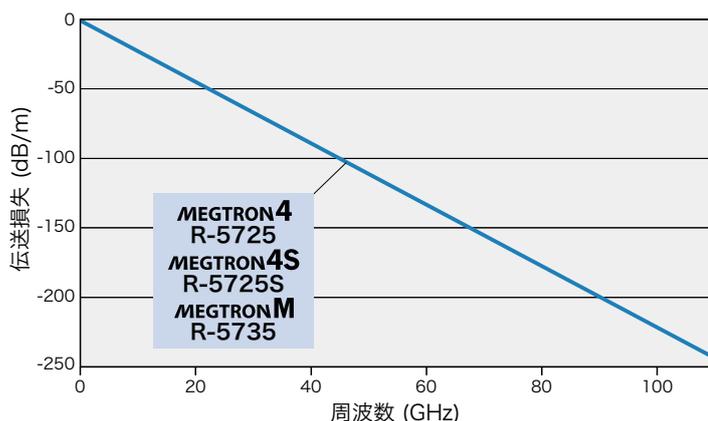
R-5630

低伝送損失・高耐熱多層基板材料

大容量データの伝送速度の高速化に対応。
高多層や基板加工時のリフロー工程に対応した耐熱性を向上
(MEGTRON4S/MEGTRON M)



伝送損失比較



構成

マイクロストリップライン



測定方法	2ポート Sパラメータ
測定周波数	10MHz~110GHz
校正方法	TRL法
インピーダンス	50Ω (Zo)

層1: 信号ライン層 (ライン幅: 270μm、銅箔厚み: 24μm)

層2: GNDプレーン層 (銅箔厚み: 24μm)

高多層耐熱性

評価結果

ドリル径	φ0.3mm	
TH壁間距離	0.6mm	0.7mm
MEGTRON4	pass	pass
MEGTRON4S	pass	pass
MEGTRONM	pass	pass

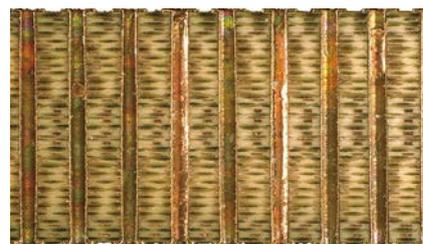
評価条件

260°Cリフロー×10回

構成

28層

板厚: 3.8mm



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	MEGTRON4 R-5725	MEGTRON4S R-5725S	MEGTRONM R-5735
ガラス転移温度(Tg)	DSC	A	°C	176	200	195
熱膨張係数 (厚さ方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	α1	35	31
				α2	265	240
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	30	50	35
比誘電率(Dk)	平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	10-13GHz	3.68 [13GHz]	3.75 [13GHz]
誘電正接(Df)				0.0074 [13GHz]	0.0087 [13GHz]	
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	1.2 [ST]	1.3 [ST]

試験片の厚さは0.8mmです。

※試験方法: IPC-TM-650 2.5.5.5

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部

Panasonic Industry MEGTRON4